

Title (en)

Method and apparatus for sanding and/or polishing a varnish coating at temperatures lower than the ambient temperature.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Schleifen und/oder Polieren einer Lackierung bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur.

Title (fr)

Procédé et dispositif pour poncer et/ou polir une laque à des températures inférieures à la température ambiante.

Publication

EP 0332956 A2 19890920 (DE)

Application

EP 89103822 A 19890304

Priority

DE 3808650 A 19880315

Abstract (en)

In the case of varnish coatings which are elastic below ambient temperature, sanding and polishing of a varnished component is possible only after cooling down the component, for example, in a cold chamber. It is therefore proposed to cool down the varnish coating by directing a blast of cold gas against it and to sand and/or polish it at the same time and/or subsequently.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schleifen und/oder Polieren einer Lackierung bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur. Bei Lacken, die unter Umgebungstemperatur elastisch sind, ist ein Schleifen und Polieren eines lackierten Bauteils nur nach Abkühlen des Bauteils beispielsweise in einer Kältekammer, möglich. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Lackierung durch Anblasen mit Kaltgas abzukühlen und gleichzeitig und/oder anschließend zu schleifen und/oder zu polieren.

IPC 1-7

B24B 1/00

IPC 8 full level

B05C 9/12 (2006.01); **B05D 3/04** (2006.01); **B05D 3/12** (2006.01); **B24B 1/00** (2006.01); **B24B 29/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

B05D 3/0426 (2013.01); **B05D 3/12** (2013.01); **B24B 1/00** (2013.01); **B24B 29/00** (2013.01); **B05C 9/12** (2013.01)

Cited by

FR2967369A1; DE19882111B4; ITUB20156872A1; US6520846B1; WO9724964A1; WO9411152A1; WO9835782A1; WO2017098535A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0332956 A2 19890920; **EP 0332956 A3 19901128**; **EP 0332956 B1 19930616**; DE 58904676 D1 19930722; ES 2042829 T3 19931216; JP H01295751 A 19891129

DOCDB simple family (application)

EP 89103822 A 19890304; DE 58904676 T 19890304; ES 89103822 T 19890304; JP 4871389 A 19890302